

장비별 적용 가능한 Wafer(시편) 규격 정보 안내

나노종합기술원

2016. 9. 6

구분	분류	장비명	MAKER(MODEL)	장비 ID	Field			Type		Materials		Thick.		Size					담당자
					All	CMOS	MEMS	Flat	Notch	Si	Glass	Normal	Special	8	6	4	Piece	Zig	
Nanodevice	Litho graphy	E-Beam Witing	JEOL(JBX-9300FS)	LEL20	o			o	o	o		o	-	o	o	o	o	김기남 (042-366-1535) (skyblue@nnfc.re.kr)	
		Manual Coating	-	LTK20	o			o	o	o	o	o	-	o	o	o	o		
		KrF Scanner	ASML(PAS5500/700D)	LSC20	o			o	o	o		o	-	o				이동욱 (042-366-1532) (dwlee@nnfc.re.kr)	
		CD SEM	Hitachi(S-9260A)	LCD10	o			o	o	o		o	-	o					
		CD SEM	JEOL(JWS-2000)	LCD20	o			o	o	o		o	-	o					
		Overlay	KLA Tencor(Archer 10XT)	LOA10	o			o	o	-	-	o	-	o					
	Etch	Back-end Dielectric Etch	LAM RESERCH(Exelan HPT)	EOX11		o		o	o	o		o		o				유동은 (042-366-1531) (deyoo@nnfc.re.kr)	
		Front-end Dielectric Etch		EOX12		o		o	o	o		o		o					
		Front-end Si Etch	LAM RESERCH(TCP9400DFM)	EPL11		o		o	o	o		o		o					
		Metal Etcher	LAM RESERCH(TCP9600DFM)	EME11		o		o	o	o		o		o					
		W Etcher	LAM RESERCH(TCP9600PTX)	EME13		o		o	o	o		o		o					
		Back-end Si Etch	LAM RESERCH(TCP9400DFM)	EPL12		o		o	o	o		o		o					
		PR Stripper	PSK(DAS2000)	EPR11		o		o	o	o		o		o					
		Implant PR Stripper	PSK(DAS2000)	EPR12		o		o	o	o		o		o					
		MEMS Metal Etcher	AMAT(DPS+)	EME30 PM1			o	o	o	o		o		o					
		CMOS Metal Etcher		EME30 PM2		o		o	o	o		o		o					
	Diffusion	Furnace (High Temp)	Centrotherm(E1200)	DHT11		o		o	o	o		o	o	o	o	o	o	황해철 (042-366-1536) (freehch@nnfc.re.kr)	
		Furnace (Gate Oxide)		DOX11		o		o	o	o		o	o	o	o	o	o		
		Furnace (Non-Metal)		DOX20		o		o	o	o		o	o	o	o	o	o		
		Furnace (Metallic Grade)		DOX32		o		o	o	o		o	o	o	o	o	o		
		Vertical Furnace		DVG10		o		o	o	o		o	o	o	o	o	o		
LPCVD (Nitride)		DNT10			o		o	o	o		o	o	o	o	o	o			
LPCVD (Poly)		DPL10			o		o	o	o		o	o	o	o	o	o			
LPCVD (TEOS)		DTE10			o		o	o	o		o	o	o	o	o	o			
Furnace (Low Temp)		DLT12			o		o	o		o	o	o	o	o	o	o			
Vacuum Furnace(Vacuum Anneal)		P&TECH(PVF-D81)		NLT 20			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		
High Current IMP		VARIAN(VISta80HP)	DIM10		o		o	o	o		o	o	o	o	o	o			
High Energy IMP		Excellis(NV-GSD-HE)	DIM21		o		o	o	o		o	o	o	o	o	o			
Non-metal RTP		NEW Young(RTA200-SP1)	DRT11		o		o	o	o		o	o	o	o	o	o			
Non-metal RTP		Metron(Heatpulse-8800)	DRT21		o		o	o	o		o	o	o	o	o	o			

장비별 적용 가능한 Wafer(시편) 규격 정보 안내

나노종합기술원

2016. 9. 6

구분	분류	장비명	MAKER(MODEL)	장비 ID	Field			Type		Materials		Thick.		Size					담당자		
					All	CMOS	MEMS	Flat	Notch	Si	Glass	Normal	Special	8	6	4	Piece	Zig			
Nanodevice	Diffusion	Metal RTP	Metron(Heatpulse-8800)	DRT32		o		o	o	o		o		o	o	o	o	o	황해철 (042-366-1536) (freehch@nnfc.re.kr)		
		MEMS RTP	NEW Young(RTP200H-SP1)	DRT 22			o	o	o	o		o	o	o	o	o	o	o			
		Furnace (MEMS Anneal)	Centrotherm(E-1200)	NLT 10			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o			
		Furnace (LS Nit / HTO)		NNT 10			o	o	o	o		o	o	o	o	o	o	o			
		Furnace (MEMS Oxide)		NOX 10			o	o	o	o		o	o	o	o	o	o	o			
		Furnace (MEMS Poly)		NPL 10			o	o	o	o		o	o	o	o	o	o	o			
		Furnace (Oxidation / Anneal)	Centrotherm(E-1550)	NOX50			o	o	o	o		o	o	o	o	o	o	o	이기성 (042-366-1534) (comesee@nnfc.re.kr)		
		CMP(1)	Doosan DND(UNIPLA230)	DCM10			o		o	o	o		o		o						
		CMP(2)		NCM20			o		o	o	o		o		o						
		MEMS CMP	Semicon tech(UNIPLA211)	NCM 10			o	o	o	o		o		o							
		Wet Station	HIT(HWB-MCP8)	DWS11			o		o	o	o		o	o	o	o	o	o		박남수 (042-366-1537) (canon@nnfc.re.kr)	
		Wet Station		DWS22			o		o	o	o		o	o	o	o	o	o			
		Wet Station	HIT(GMW-05)	DWS33			o		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o			
		Wet Station (Non metal)	HIT(HWC-MCP)	NWS 11				o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o			
		Wet Station (Metal)		NWS 22				o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o			
	Wafer Scrubber	L-Trin(LTS200)	DSC10			o		o	o	o		o		o							
	Thin Film	SiH4 Base PECVD (SiO2, SiN, SiON)	NOVELLUS(SEQUEL/SPEED)	TPE11			o		o	o	o		o		o	o	o	o	박상현 (042-366-1538) (kmc864@nnfc.re.kr)		
		STI HDP (Oxide)		TPE12			o		o	o	o		o		o						
		IMD HDP (Oxide)	JUSUNG(ENG EURACA)	TPE21			o		o	o	o		o		o						
		PE-TEOS	AMAT(P5000)	TPE31			o		o	o	o		o		o	o	o	o			
		BPSG		TPE32			o		o	o	o		o		o	o	o	o			
		a-Si PECVD (a-Si, a-c)	AMAT(P5000)	TPE40 (3ch)			o		o	o	o		o		o	o	o	o			
		PE Oxide DEP						o	o	o		o		o	o	o	o	o			
		ACL DEP						o	o	o		o		o	o	o	o	o		o	
		PE-TEOS Dep	NOVELLUS(SEQUEL)	NPE30			o	o	o	o		o	o	o	o	o	o	o			
		PEOX/PENIT Dep	TES(TELIA-200))	NPE40			o	o	o	o		o	o	o	o	o	o	o			
		Sputter (IMP Ti)	AMAT(ENDURA-5500)	TSP11			o		o	o	o		o		o	o	o	o		o	강민호 (042-366-1533) (kmh@nnfc.re.kr)
		Sputter (MOCVD TiN)		TSP12			o		o	o	o		o		o	o	o	o		o	
Sputter (ESC Al)		TSP13				o		o	o	o		o		o	o	o	o	o			
Sputter (Co)	TSP14				o		o	o	o		o		o	o	o	o	o				
Sputter (PVD Ti/TiN)	TSP15				o		o	o	o		o		o	o	o	o	o				
CVD W	AMAT(P5000)	TCW10			o		o		o		o		o								
ALD (Atomic layer deposition)	IPS(Nano-ALD 2000)	DAL10			o		o	o	o		o		o	o	o	o	o				

장비별 적용 가능한 Wafer(시편) 규격 정보 안내

나노종합기술원

2016. 9. 6

구분	분류	장비명	MAKER(MODEL)	장비 ID	Field			Type		Materials		Thick.		Size					담당자					
					All	CMOS	MEMS	Flat	Notch	Si	Glass	Normal	Special	8	6	4	Piece	Zig						
MEMS Sensor	Litho graphy	KrF Nikon Inline Scanner	Nikon(NSR-S203B)	LST10	o			o		o		-	-	o							김광희 (042-366-1566) (khkim@nnfc.re.kr)			
		KrF Track	SEMES(K-Spin8)	LTK10	o			o		o		-	-	o										
		Mask Generator	Heidelberg(DWL200)	NMF10	o			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o						
		I-line Stepper 1(8inch)	Nikon(NSR-2205i11D)	LST10	o			o		o					o									
		I-line Stepper 2(8inch)	NIKON(NSR2205 i11D)	LST20	o			o		o					o									
		i-line Track - coat/dev	TEL(MARK-8)	LTK30	o			o	o	o	o	o	o	o	o									
		MEMS Track for Aligner(Thick PR)	TEL(Mark-7)	NTK20	o			o	o	o	o	o	o	o	o								한창희 (042-366-1562) (chhan@nnfc.re.kr)	
		Auto Thick PR Spin Coater	ASP-2000	NTK30	o			o	o	o	o	o	o	o	o									
		Auto Thick PR Spin Developer	ASP-2000	NTK40	o			o	o	o	o	o	o	o	o									
		Manual Coater	특주	NTK50	o			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		
		E Beam System (ELIONIX)	ELONIX(ELS-7000)	LEL20	o			o		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		
		Particle counter_Bare wafer	KLA Tencor (Surfscan SP-1 Classic)	LDI10	o			o	o	o	o		o		o									
		Contact Aligner	EVG(EVG640)	NCL10	o			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		
		Contact Aligner (Thick PR)	EVG(EVG640)	NCL20	o			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		
		Exposer	특주	NCL30	o			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	서창호 (042-366-1565) (shine6u@nnfc.re.kr)	
	Double Side Alignment Aligner -1	USHIO	NCL40	o			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o			
	Double Side Alignment Aligner -2	USHIO	NCL50	o			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o			
	Polymer Etcher	UNAXIS	NDE10			o	o		o	o	o	o	o	o		o	o	o	o	o	o			
	PR Stripper-NEMS 전용	PSK(TS200)	NPR10			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o			
	Organic & Inorganic Dry PR Stripper	PSK(DAS2000)	EPR30			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o			
	Deep Si Etch- 8/6 inch	ALCATEL(AMS200)	EDT20	o			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	노길선 (042-366-1561) (ksnoh@nnfc.re.kr)		
	Si Micro-machinable etcher	STS(VPX-Pegasus)	EDT30	o			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o			
	Dielectric Etcher-BEOL	TEL(SCCM)	EOX20	o			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o			
	HAR Dielectric Ox Etcher	Oxford(ICP380)	EOX30			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o			
	Metal Etcher- Al,Ti,TiN,W	OXFORD(Plasma System 100)	EME20	o			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o			
	Release Etcher (XeF2)	SPP(CVE)	ERE10			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o			
	Gas Phase Etcher (Vapor HF)	SPP(SLE)	EGP10			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o			
	NEMS - E-Beam Evaporator 1	KOREA VACUUM(KVET-C500200)	NEV20			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	심갑섭 (042-366-1563) (gssim@nnfc.re.kr)		
	NEMS - E-Beam Evaporator 2	EVATEC(BAK641)	NEV30			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o			
	Multi Layer Evaporator	인포비온(ipe801)	NEV40			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o			
	NEMS - Multi Target Sputter 1	SORONA(SS0818)	NSP10			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o			
	NEMS - Multi Target Sputter 2	SORONA(SRN-110)	NSP20			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o			
	Endura-Sputter (Cu Inter Connexion)	AMAT(ENDURA-5500)	TSP20			o		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o			
	NEMS - Electroplating 1	SEWOO(Dip Plater)	NEP10	o			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	김경민 (042-366-1569) (kkm@nnfc.re.kr)		
	NEMS - Electroplating 2	EEJJA(Cup-plater)	NEP20	o			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o			
	NEMS - Low Stress PECVD	UNAXIS(SLR-730)	NPE10			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o			
	NEMS - PECVD(auto)	AMAT(P5000)	NPE20			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o			
	Dicing sawing - Glass	NEON TECH(ND5-1012)	BDM20	o			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o			
	Dicing sawing - Si	DISCO(DAD3351)	BDM10	o			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o			
	Dicing Saw	DISCO(DFD6340)	BDM30	o			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o			
Nano second laser	Exitech(MicrAblater M2000E/Y)	BNS10	o			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				
Laser Source Marker	이오테크(WM-080)	BLM10	o			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				
Reflow	Speedline Technologies (Bravo8105)	BRF10			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				
Critical Point Dryer	Tousimis(916B, Series C)	NCP20			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				
Wafer Bonder 1	EVG520HE	BFB10	o			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	김태현 (042-366-1564) (thk@nnfc.re.kr)			
Wafer Bonder 2	EVG520IS	BFB20	o			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				
Wafer Bonder 3	EVG(GEMINI)	BFB30	o			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				
Edge Grinder	다이트론코리아(WBM-210)	PEG20	o			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				
Back Grinder	DISCO(DGP8760)	PBG10	o			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				